

職能單元代碼	MPM3R2911v2
職能單元名稱	切割模擬測試與雷射切割
職類別	製造 / 生產管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	<p>一、料件雷射切割機台模擬測試</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 評估切割料件後，進行光路架設並確認電腦模擬操作。 2. 進行光路架設完成模擬並進行驗證。 <p>二、切割機台定位</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 機台原點復歸及定位工作原點。 2. 判定機台或鏡頭的堪用程度。 3. 設定氣體壓力進給速度切削功率等切割條件。 <p>三、雷射切割打樣操作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依據客戶提供產品各種材質，進行材料切割條件的判定。 2. 根據實驗測試結果，分析實驗數據。 3. 根據擬定的實驗規劃，執行產品打樣及測試並產出測試報告書。 <p>四、雷射切割製程操作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依據工作圖面進行工作分析與操作。 2. 依製程進行實務切割作業。
工作產出	<ul style="list-style-type: none"> • 打樣測試報告書
職能內涵 (K=knowledge知識)	<ul style="list-style-type: none"> • 光路架設概論 • 切割機台調校概論 • 雷射加工特性分析方法 • 品質管制方法 • 光學料件概論 • 光路架設概論 • 職業安全衛生相關規範 • 精密量測概論
職能內涵 (S=skills技能)	<ul style="list-style-type: none"> • 製作夾(治)具能力 • 文書撰寫能力

	<ul style="list-style-type: none"> • 料件打樣操作能力 • 切割機台操作能力 • 雷射切割操作能力 • 雷射切割模擬測試操作能力 • 個人防護裝備使用能力
說明與補充事項	無